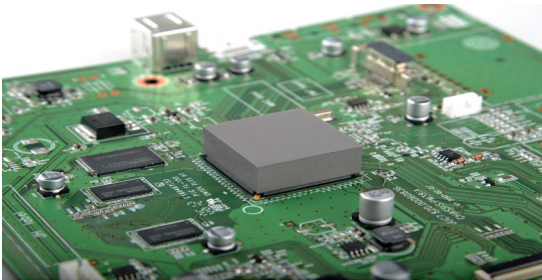


高导热硅胶垫片

TP1500-Q是一款无交联的高导热有机硅导热垫片，导热系数15W/(m·K)，无交联状态使其没有橡胶的回弹性，但是具有非常好的压缩性且高压缩后应力非常小，易于装配。



特性和优点

- 导热系数: 15.0W/(m·K)
- 超柔软
- 无交联
- 高电气绝缘
- 韧性好易操作
- 高压缩率

典型应用

- 电压调节模块 (VRMs)
- IGBT
- 高导热需求模块
- 高热量BGAs
- 电信设备
- 网络通信设备

典型属性		
属性	典型值	测试方法
颜色	灰色	目视
厚度(mm)	0.5~5.0	ASTM D374
密度(g/cc)	3.2	ASTM D792
硬度(Shore 00)	40	ASTM D2240
耐温范围(°C)	-40~150	/
防火性能	V-0	UL 94
存储保质期(月)	12	温度<40°C避免挤压、暴晒
电性能		
击穿电压(kV/mm)	≥5.0	ASTM D149
介电常数	7.0	ASTM D150
体积电阻率(Ω·cm)	10 <sup>12</sup>	ASTM D257
导热性能		
导热系数(W/(m·K))	15	ISO 22007-2
热阻(°C·in <sup>2</sup> /W @50psi)	≤0.065	ASTM D5470